PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2000-212453

(43)Date of publication of application: 02.08.2000

(51)Int.Cl.

C08L101/00 C08K 3/04 C08K 7/06 C08K 9/00 H01B 1/24

(21)Application number: 11-017697

(71)Applicant: OSAKA GAS CO LTD

(22)Date of filing:

26.01.1999

(72)Inventor: KAKEGAWA HIROYA

(54) CONDUCTIVE POLYMER MATERIAL COMPOSITION AND CONDUCTIVITY CONTROL MEMBER

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a polymer material whose conductivity is inexpensively controlled to a desired level.

SOLUTION: The conductive polymer material composition comprises a polymer material and a conductivity control material. The conductivity control material is obtained through a preparation procedure comprising the steps of compressing fibers impregnated with a binder resin and made of natural fibers to obtain a molded product and heating the thus obtained molded product for carbonization. This composition may further comprise carbon fibers.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2000-212453 (P2000-212453A)

(43)公開日 平成12年8月2日(2000.8.2)

		(10) ZADELI I MALE	T 0 /1 2 L1 (2000: 0: 2)
(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
C08L 101/00		C 0 8 L 101/00	4J002
C08K 3/04		C08K 3/04	5 G 3 O 1
7/06		7/06	
9/00		9/00	
H01B 1/24		H01B 1/24	Z
·		審査請求 未請求 請求項の数	
(21)出願番号	特願平11-17697	(71)出願人 000000284	
		大阪瓦斯株式会社	
(22)出顧日	平成11年1月26日(1999.1.26)	大阪府大阪市中央区	平野町四丁目1番2号
		(72)発明者 掛川 宏弥	
		· ·	平野町四丁目1番2号
		(74)代理人 100099841	•
		弁理士 市川 恒彦	
		71.22	
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 導電性高分子材料組成物および導電性調整材

(57)【要約】

【課題】 高分子材料の導電性を所望の状態に安価に調整する。

【解決手段】 導電性高分子材料組成物は、高分子材料 と導電性調整材とを含んでいる。導電性調整材は、バイ ンダーが含浸された天然繊維からなる繊維群を圧縮して 成形体を得るための工程と、得られた成形体を加熱して 炭化するための工程とを含む製造工程を経て得られてい る。この組成物は、炭素繊維をさらに含んでいてもよ い。

【特許請求の範囲】

【請求項1】高分子材料と導電性調整材とを含み、 前記導電性調整材は、バインダーが含浸された天然繊維 からなる繊維群を圧縮して成形体を得るための工程と、 前記成形体を加熱して炭化するための工程とを含む製造 工程を経て得られている、導電性高分子材料組成物。

1

【請求項2】前記天然繊維が綿である、請求項1に記載 の導電性高分子材料組成物。

【請求項3】前記バインダーが加熱処理後に炭素を残し 得る炭素前駆体である、請求項1または2に記載の導電 10 の導電性を微妙に調整して上述の範囲に設定するのは極 性高分子材料組成物。

【請求項4】前記成形体を炭化する際の加熱温度が60 0~2,800℃である、請求項1、2または3に記載 の導電性高分子材料組成物。

【請求項5】炭素繊維を更に含んでいる、請求項1、 2、3または4に記載の導電性高分子材料組成物。

【請求項6】バインダーが含浸された天然繊維からなる 繊維群を圧縮して成形体を得るための工程と、

前記成形体を加熱して炭化するための工程と、を含む製 造工程を経て得られた導電性調整材。

【発明の詳細な説明】

[0001]

- 【発明が属する技術分野】本発明は、高分子材料組成 物、特に導電性高分子材料組成物に関する。

[0002]

【従来の技術とその課題】高分子材料は、一般に優れた 電気絶縁性を示すことから、電気・電子部品分野におい て広く用いられている。ところが、高分子材料そのもの からなる電気・電子部品材料は、一般に電気絶縁性を有 するために帯電し易く、塵埃の付着或いは放電により 1 30 Cなどの電子部品へダメージを与える等の不具合があ る。このため、半導体製造分野において用いられる高分 子材料は、通常、導電材を加えて微弱な導電性が付与さ れている。

【0003】ところで、高分子材料に導電性を付与する ための導電材として、カーボンブラックが広く知られて いる。ところが、カーボンブラック、特にアセチレンブ ラックやケッチェンブラックは、それ自体が高い導電性 を示す粉体であることから、高分子材料の導電性を段階 的に緩やかに調整するのが困難である。すなわち、カー 40 ボンブラックは、添加量を僅かに変化させるだけで、高 分子材料の導電性を急激に変化(例えば、10°Ω c m 程度の範囲で変化)させてしまい、高分子材料の導電性 を微妙に変化させるためには不適当である。このため、 カーボンブラックを導電材として用いた場合、電子部品 分野で用いられる高分子材料に対して一般に要求される ことが多い導電性、すなわち10°~10°Ω c m程度 の微弱な導電性を安定的に付与するのは極めて困難であ る。しかも、カーボンブラックは、上述のように粉体で

材料に対する添加時に分散不良が生じ易く、成形体から の脱落(粉落ち)によるコンタミネーションを惹起する おそれもある。

【0004】また、カーボンブラックに代わる導電材と して、コンタミネーションを起こし難い炭素繊維が利用 されつつある。しかし、この炭素繊維は高価であり、高 分子材料に対する添加量が増加するに従って、複合材料 が高価になる。また、炭素繊維は、カーボンブラックと 同様に導電性が非常に高い材料であるため、高分子材料 めて困難である。

【0005】本発明の目的は、高分子材料の導電性を所 望の状態に安価に調整することにある。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明に係る導電性高分 子材料組成物は、樹脂と導電性調整材とを含んでいる。 導電性調整材は、バインダーが含浸された天然繊維から なる繊維群を圧縮して成形体を得るための工程と、得ら れた成形体を加熱して炭化するための工程とを含む製造 20 工程を経て得られている。

【0007】ここで、導電性調整材に用いられる天然繊 維は、例えば綿である。また、バインダーは、例えば、 加熱処理後に炭素を残し得る炭素前駆体である。さら に、成形体を炭化する際の加熱温度は、例えば600~ 2, 800°Cである。

【0008】なお、本発明に係る導電性高分子材料組成 物は、例えば、炭素繊維を更に含んでいる。

【0009】本発明に係る導電性調整材は、バインダー が含浸された天然繊維からなる繊維群を圧縮して成形体 を得るための工程と、得られた成形体を加熱して炭化す るための工程とを含む製造工程を経て得られたものであ

[0010]

【発明の実施の形態】本発明の導電性高分子材料組成物 は、高分子材料と導電性調整材とを含んでいる。本発明 で用いられる高分子材料は、特に限定されるものではな く、公知の各種の熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂およびゴ ムなどである。

【0011】ここで、熱可塑性樹脂としては、例えば、 ポリエチレン樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン 樹脂およびポリアクリルスチレン樹脂などの汎用プラス チック、アクリルーブタジエンースチレン樹脂(AB S),ポリフェニルエーテル樹脂,ポリアセタール樹 脂、ポリカーボネート樹脂、ポリブチレンテレフタレー ト樹脂、ポリエチレンテレフタレート樹脂、ナイロン6 およびナイロン6、6などのエンジニアリングプラスチ ック、並びにポリエーテルエーテルケトン樹脂、ポリア ミド樹脂, ポリイミド樹脂, ポリスルホン樹脂, 4-フ ッ化エチレンーエチレン共重合体樹脂、ポリフッ化ビニ あることから、取り扱いが容易ではなく、また、高分子 50 リデン樹脂、4-フッ化エチレンーパーフルオロアルキ

ルビニルエーテル共重合体樹脂、ポリエーテルイミド樹 脂、ポリエーテルサルフォン樹脂、ポリフェニレンサル ファイド樹脂,変性ポリフェニレンオキサイド樹脂,ポ リフェニレンエーテル樹脂および液晶ポリマーなどの超 エンジニアリングプラスチックなどを挙げることができ る。また、熱硬化性樹脂としては、例えば、フェノール 樹脂、エポキシ樹脂、ポリイミド樹脂および不飽和ポリ エステル樹脂などを挙げことができる。さらに、ゴムと しては、天然ゴム、イソプレンゴム、ブタジエンゴム、 スチレンーブタジエンゴム、クロロプレンゴム、ニトリ 10 ミン樹脂のうちの少なくとも1つの熱硬化性樹脂が好ま ルゴム、エチレンープロピレンゴム、アクリルゴム、エ ピクロルヒドリンゴム、多硫化ゴム、ウレタンゴム、ポ リオレフィン系エラストマーおよびシリコーンゴムなど を挙げることができる。

【0012】一方、本発明で用いられる導電性調整材 は、下記の製造工程を経て得られるものである。先ず、 バインダーが含浸された天然繊維からなる繊維群を圧縮 して成形体を得る。ここで用いられる天然繊維は、例え ば、綿、パルプ、絹、麻等である。このうち、安価な綿 が特に好ましい。

【0013】本発明で用いられる天然繊維の平均アスペ クト比(平均繊維長/平均繊維径)は、少なくとも5、 例えば、5~2,000に設定されているのが好まし く、10~1,800に設定されているのがより好まし く、20~1,500に設定されているのがさらに好ま しい。平均アスペクト比が5未満の場合は、高分子材料 に対する導電性の付与効果が低下するおそれがある。逆 に、2,000を超える場合は、高分子材料に対する定 量供給が困難になるおそれがある。なお、平均アスペク ト比は、一般に、高分子材料に対する定量供給が可能な 30 限り大きい方が、高分子材料との複合後の残存アスペク ト比を大きくでき、その結果高分子材料に対して導電性 を付与し易くなるため好ましい。因みに、この平均アス ペクト比の基準になる平均繊維径は、光学顕微鏡または 走査型電子顕微鏡(SEM)により求めることができ

【0014】上述の天然繊維に含浸されるバインダー は、天然繊維同士を接着して一体化させることができる ものであれば特に限定されるものではないが、通常は加 熱処理後に炭素を残す高分子材料系の炭素前駆体、特 に、不活性ガス中において600℃で加熱した後の炭化 収率が1~80重量%のもの、好ましくは5~60重量 %のもの、より好ましくは10~50重量%のものであ る。この炭化収率が1重量%未満の場合は、後述する炭 化工程において、加熱処理後の成形体が脆くなり、崩れ やすくなる。この結果、炭化された成形体と高分子材料 とを混合して本発明の組成物を調製する際、特にフィー ダーを用いて成形体を高分子材料に対して供給する際 に、成形体が崩れやすくなり、成形体を高分子材料に対 して安定に定量供給するのが困難になる。

【0015】本発明で用いられる上述の炭素前駆体は、 上述のような炭化収率を有するものであれば特に限定さ れるものではなく、公知の各種のものである。具体的に は、例えば、ポリビニルアルコール、リグニン、フェノ ール樹脂、フラン樹脂、ウレタン樹脂、メラミン樹脂、 カルボキシメチルセルロース、ポリフェニレンオキサイ ド、ポリエーテルサルホン、コールタール、ピッチ、ポ リスルフォン等を用いることができる。これらのうち、 フェノール樹脂、フラン樹脂、ウレタン樹脂およびメラ しい。なお、これらの炭素前駆体は、必要に応じて2種 以上のものが混合して用いられてもよい。

【0016】上述の天然繊維に対して上述のバインダー を含浸する場合は、先ず、バインダーを含む溶液 (バイ ンダー溶液) を調製し、この溶液を天然繊維に対して含 浸させる。ここで用いられるバインダー溶液は、通常、 上述のバインダーを有機溶媒に溶解したもの(有機溶媒 溶液)、または上述のバインダーのエマルジョンであ る。有機溶媒を用いる場合、利用するバインダーを溶解 20 することができるものであればその種類は特に限定され るものではないが、一般にはアルコール類、ケトン類、 ハロゲン化炭化水素類などを用いることができる。

【0017】バインダー溶液を天然繊維に対して含浸す るための方法としては、各種の方法、例えば、バインダ 一溶液中に天然繊維を浸漬する方法や、天然繊維に対し てバインダー溶液を吹き付ける方法などを採用すること ができる。

【0018】なお、バインダー溶液は、有機溶媒溶液お よびエマルジョンのいずれの場合も、天然繊維に対して 付与されるバインダー量が乾燥後の固形分換算で0.1 ~5重量%になるよう天然繊維に対して含浸されるのが 好ましい。天然繊維に対して付与されるバインダー量が 0. 1 重量%未満の場合は、天然繊維同士の接着性が低 下し、天然繊維による成形体を製造しにくくなるおそれ がある。また、後述する工程により得られる加熱処理後 (炭化処理後) の成形体(すなわち、導電性調整材) の 嵩密度が低下するおそれがある。逆に、5重量%を超え る場合は、加熱処理後(炭化処理後)の成形体、すなわ ち導電性調整材と高分子材料との混合時に、導性調整材 40 が崩れにくくになり、結果的に導電性調整材が高分子材 料中に繊維状態で均一に分散しにくくなるおそれがあ る。なお、天然繊維に対して付与される上述のバインダ 一溶液量のより好ましい範囲は0.5~3重量%であ る。

【0019】次に、上述のようにしてバインダーが含浸 された天然繊維の多数本からなる群、すなわち繊維群を 圧縮成形する。圧縮成形により達成する形状は特に限定 されるものではないが、通常は板状、棒状およびペレッ ト状などである。このような成形体の嵩密度は、通常、 50 少なくとも O. 1 g / c c に設定するのが好ましく、少

なくとも0.4g/ccに設定するのがより好ましい。 【0020】圧縮成形時の設定圧力は、通常、10~ 1,000kg/cm^{*}に設定するのが好ましく、50 ~500kg/cm゚に設定するのがより好ましい。ま た、この圧縮成形工程は、繊維群の成形性を高めるため に、繊維群を加温しながら実施することができる。その 場合の設定温度は、通常、50~200℃に設定するの が好ましく、100~180℃に設定するのがより好ま しい。

【0021】次に、得られた成形体を加熱して炭化す る。ここでは、通常、成形体を窒素等の不活性ガス雰囲 気中において加熱処理し、成形体を炭化させる。なお、 加熱処理工程に先立って、成形体は、予め高分子材料に 対してフィードし易い形状(例えばペレット状)に適宜 切断等されていてもよい。この加熱工程では、成形体を 構成する天然繊維およびバインダーが炭化され、成形体 は、炭化された天然繊維が炭化されたバインダーによっ て緩やかに相互に結合した導電性調整材になる。

【0022】上述のような成形体の加熱処理時に設定す べき加熱温度は、成形体、すなわち天然繊維およびバイ 20 ンダーの両方が炭化し得る温度範囲であり、通常、60 0~2,800℃の範囲である。この場合の昇温速度 は、一般に、成形体の熱重量分析結果における重量変化 の大きい温度領域を比較的低速に設定し、重量変化の小 さい温度領域を比較的高速に設定するのが好ましい。

【0023】加熱処理後に得られる導電性調整材は、成 形体の加熱処理時の最高温度の高低によって繊維群電気 抵抗値が変化し得る。すなわち、成形体を低温で加熱処 理して得られた導電性調整材は繊維群電気抵抗値が大き く、成形体を高温で加熱処理して得られた導電性調整材 は繊維群電気抵抗値が小さくなる。このため、成形体の 加熱処理時の温度設定を適宜調整することにより、導電 性調整材による高分子材料に対する導電性の付与効果を 調整することができる。例えば、加熱処理時の温度が高 温に設定された場合は導電性調整材の繊維群電気抵抗値 が小さくなるため、その導電性調整材は、高分子材料に 対する添加量を変化させると、当該高分子材料の導電性 を変化させ易くなる。逆に、加熱処理時の温度が低温に 設定された場合は導電性調整材の繊維群電気抵抗値が大 きくなるため、その導電性調整材は、高分子材料に対す る添加量に比例して、高分子材料の導電性を緩やかに変 化させることができる。

【0024】なお、本発明でいう上述の繊維群電気抵抗 値とは、炭化された天然繊維の個々の電気抵抗値ではな く、炭化された多数の天然繊維を含む導電性調整材全体 としての電気抵抗値であり、次のようにして求められる ものをいう。先ず、中心部に直径0.8cmの貫通孔を 有する電気絶縁体を用意し、その貫通孔の一端を銅製の 電極で封止する。そして、貫通孔内に 0.5gの導電性

して20kgf/cm²の圧力を加えて導電性調整材を 高さxcmの円柱状に成形する。この状態で電極と押し 棒との間に測定器を接続し、貫通孔内で圧縮された導電 性調整材の電気抵抗値を測定する。繊維群電気抵抗値 は、測定された電気抵抗値に導電性調整材の成形体の端 面の面積(すなわち、 $0.4^2\pi cm^2$)を掛け、その値 を高さ x c mで割ると体積抵抗値 (Ω c m) として求め ることができる。導電性調整材の電気抵抗値を測定する 際に用いられる測定器は、ブランク時の電気抵抗値、す 10 なわち、電極と押し棒とを直接に接触させた場合の電気 抵抗値をキャンセルできるものが好ましく、例えば、ア ドバンテスト株式会社のデジタルマルチメーター "R6 552"を挙げることができる。以下、繊維群電気抵抗 値と言う場合は、このようにして求めた導電性調整材の 体積抵抗値を言うものとする。

【0025】因みに、本発明で用いられる導電性調整材 の繊維群電気抵抗値として好ましい範囲は、通常、0. 001~1,000Ωcm、より好ましくは0.01~ 1 Ω c m である。

【0026】加熱処理前の成形体が高分子材料に対して フィードし易い形状に予め切断等されていない場合、得 られた導電性調整材は、高分子材料に対してフィードし 易い形状に適宜切断等されてもよい。

【0027】本発明の導電性高分子材料組成物は、所望 により、炭素繊維をさらに含んでいてもよい。ここで用 いられる炭素繊維は、特に限定されるものではなく、高 分子材料に対して導電性を付与するために通常用いられ る公知の各種のものである。具体的には、例えば、ポリ アクリロニトリル系炭素繊維, 等方性ピッチ系炭素繊 維、異方性ピッチ系炭素繊維、カイノール樹脂系炭素繊 維および黒鉛繊維を挙げることができる。また、炭素繊 維は、2種以上のものが併用されてもよい。

【0028】因みに、本発明で用いられる炭素繊維は、 繊維群電気抵抗値(既述の方法により測定される電気抵 抗値:但し、「導電性調整材」を「炭素繊維群」と読み 替えるものとする) が 0. 001~1, 000Ωcmの ものが好ましく、 $0.01\sim0.5\Omega$ cmのものがより 好ましい。

【0029】本発明の導電性高分子材料組成物を製造す る場合は、通常、高分子材料に対し、公知の各種のフィ ーダー等を用いて上述の導電性調整材および必要に応じ て炭素繊維を供給して混合する。この際、導電性調整材 と炭素繊維とは、高分子材料に対して別個に供給されて もよいし、予め混合された後に高分子材料に対して供給 されてもよい。

【0030】高分子材料に対する導電性調整材の添加量 は、目標とする高分子材料の導電性(電気抵抗値)に応 じて適宜設定することができる。この際、導電性調整材 は、天然繊維を用いて上述のような工程を経て製造され 調整材を充填し、貫通孔の他端から銅製の押し棒を挿入 50 たものであるため、炭素繊維の場合と異なり、添加量を

10

7

徐々に増加させるに従って高分子材料の導電性を段階的に徐々に高めて行くことができる。換言すると、本発明で用いられる導電性調整材は、高分子材料に対する添加量を僅かに変化させた程度では、高分子材料の導電性を大幅に変化させ難い。また、本発明で用いられる導電性調整材は、天然繊維を用いて製造されているため、本発明の開発を大幅に比べて格段に安価である。このため、本発明の電性高分子材料組成物は、カーボンブラックや炭素繊維等を用いて導電性が付与された従来の高分子材料組成物では達成するのが困難であった、10°~10°Ωcm程度の微弱な導電性を、導電性調整材の添加量を加減することにより、容易にしかも安価に達成することができる。

【0031】また、本発明の導電性高分子材料組成物が 炭素繊維を含む場合、本発明で用いられる導電性調整材 は、炭素繊維だけでは達成し難い電気抵抗値を高分子材 料に対して付与するための補助的な導電性調整材として 機能し得る。例えば、既述のように、炭素繊維は、導電 性が高いために高分子材料に対する添加量を僅かに変化 させるだけで高分子材料の導電性を急激に変化させてし まい、高分子材料の導電性を半導体関連部品分野で要求 されることが多い10°~10°Ωcm程度の微弱な範 囲に設定するのが困難であるが、本発明の導電性高分子 材料組成物は、添加量が変化しても高分子材料の導電性 を急激には変化させ難い上述の導電性調整材を含んでい るため、炭素繊維の添加量を必要最低限に設定しながら その導電性を例えば $10^5 \sim 10^{13} \Omega c m$ の範囲内の目 的の電気抵抗値の近傍に設定できるようにし、同時に上 述の導電性調整材の添加量を調整することにより、高分 子材料の電気抵抗値を10⁵~10¹³ Ω c mの範囲内の 目的の電気抵抗値に容易に設定することができる。因み に、この場合は、炭素繊維の添加量を極力抑制しつつ、 上述の安価な導電性調整材により目的の電気抵抗値を高 分子材料に対して付与することができるので、本発明の 導電性高分子材料組成物は、炭素繊維のみを用いた従来 のものに比べて安価に設定し得る。また、この場合は、 高分子材料に対する炭素繊維および導電性調整材の両方 の添加量を極力抑制することができるので、本発明の導 電性高分子材料組成物は、単に安価に構成できるだけで はなく、高分子材料により本質的に得られる各種の特 性、例えば、摺動性や機械的強度等が損なわれにくい成 形体を実現することができる。

【0032】さらに、本発明の導電性高分子材料組成物に含まれる上述の導電性調整材は、高分子材料に対して供給された後の繊維長(残存繊維長)が比較的長く(すなわち、高分子材料に対する供給時において砕けて短くなりにくく)、本発明の導電性高分子材料組成物からなる成形体の内部に安定に保持され易い。したがって、この導電性調整材は、導電性高分子材料組成物の成形体から脱落しにくく、後述する半導体製造用治具等として用50

いられた場合であってもコンタミネーションを引き起こ し難い。

【0033】本発明の導電性高分子材料組成物は、上述のような導電性調整材を含み、導電性が付与されているため、帯電防止や埃の付着防止が求められる分野、例えば半導体製造用治具、ICトレー、キャリヤーの成形用材料等の各種の用途に利用することができる。

[0034]

【実施例】製造例(導電性調整材の製造)

フェノール樹脂(固形分が58重量%のレゾール樹脂: 住友ベークライト株式会社の商品名"スミライトレジン PR53717")にアセトンとメタノールとを2: 1の割合で混合した混合溶媒を添加し、フェノール樹脂 の濃度が5重量%の樹脂溶液を得た。

【0035】得られた樹脂溶液中に平均アスペクト比が600のストランド状の綿を浸漬した後に取り出し、乾燥後のフェイール樹脂含浸量が固形分換算で2重量%になるよう絞り機にかけて樹脂溶液量を調整した。

【0036】次に、樹脂溶液が含浸された綿を、190℃に設定されたプレス機を用いて100kg/cm²の圧力で5分間加圧成形し、綿の嵩密度が0.4g/ccでありかつ大きさが300mm×300mm×3mmの板状の成形体を得た。続けて、この成形体を炭化炉内に入れ、窒素雰囲気下において、室温~230℃の間を6.6℃/分、230~350℃の間を1℃/分、350~470℃の間を2℃/分、470~1,000℃の間を5℃/分の割合で昇温させながら徐々に加熱し、最終温度である1,000℃で2時間さらに加熱処理して炭化させた。この際の炭化収率は22.5重量%であった。炭化後の成形体を3mm角に切断し、導電性調整材を得た。この導電性調整材の繊維群電気抵抗値は、0.8Qcmであった。

【0037】この導電性調整材について、高分子材料で あるポリプロピレン樹脂(日本ポリケム株式会社の商品 名"ノバテックBC3B") に対して供給した後の残存 繊維長を調べた。ここでは、2軸押出機 (プラスチック 工学研究所の商品名"BT40")を用いてポリプロピ レン樹脂に対して導電性調整材を10重量%の割合で供 給し、その後の導電性調整材の残存繊維長とその重量分 布との関係を光学顕微鏡画像解析装置(オリンパス株式 会社の商品名"XL500")を用いて測定した。結果 を図1に示す。なお、この測定結果から求められた導電 性調整材の残存繊維長の重量平均値は、約108μmで あった。これより、この導電性調整材は、高分子材料に 対して供給された場合に崩れにくく、短くなり難いこと がわかり、その結果、カーボンブラックなどの導電性付 与材を用いた場合に生じ易い粉落ちによるコンタミネー ションを引き起こし難いことがわかる。

【0038】<u>実施例1~4</u>

高分子材料であるポリフェニレンオキサイド樹脂(日本

10

ゼネラルエレクトリック株式会社の商品名"ノリル05 34") に対して上述の製造例で得られた導電性調整材 と、平均繊維径が12μmでありかつ平均アスペクト比 が250の等方性ピッチ系炭素短繊維(大阪ガスケミカ ル株式会社の商品名" Xylus GC03J40 1") からなる、繊維群電気抵抗値が0.14Ωcmの 炭素繊維群とを混合し、導電性高分子材料組成物を得 た。ここでは、ポリフェニレンオキサイド樹脂中におけ る導電性調整材と炭素繊維群との合計量が12重量%に なるよう設定し、その合計量の中で導電性調整材と炭素 10 繊維群との割合が表1に示す通りになるよう設定した。 なお、ポリフェニレンオキサイド樹脂に対する導電性調 整材および炭素繊維群の供給は、2台の定量フィーダー を用い、各定量フィーダーから導電性調整材と炭素繊維 群とを別個にポリフェニレンオキサイド樹脂に対して供 給した。

【0039】得られた導電性高分子材料組成物をペレット状に成形し、このペレットを、樹脂温度300℃、射出圧力1,500kg/cm²および金型温度160℃の条件で住友重機械工業株式会社製のPROMAT射出20成形機を用いて成形し、直径50mm、厚さ3mmの円板、すなわち高分子材料成形体を得た。得られた円板の表面に銀ペーストを用いて一対の電極を形成し、当該電極間の電気抵抗を測定して円板の表面抵抗(Ω/□)を*

* 求めた。結果を表1および図2に示す。なお、以下、 「表面抵抗」と言う場合は、このようにして測定した電 気抵抗値を言うものとする。

【0040】表1および図2より、本実施例の導電性高分子材料組成物は、導電性調整材と炭素繊維群との合計量を一定にし、その合計量の範囲の中で両者の割合を変更することにより、円板の表面抵抗を概ね10°~10°Ω/□の範囲で段階的に緩やかに設定できることがわかる。

0 【0041】<u>比較例1,2</u>

実施例1~4において、導電性調整材を用いずに炭素繊維群のみを用いて導電性高分子材料組成物を調製し、この導電性高分子材料組成物(炭素繊維群含有量=12重量%(比較例1)および9重量%(比較例2))を用いて実施例1~4の場合と同様にして高分子材料成形体(円板)を得た。得られた円板について、実施例1~4の場合と同様にして表面抵抗を調べた結果を表1に示す。この結果より、導電性高分子材料組成物が炭素繊維群のみを含む場合、炭素繊維群の添加量が少量変化するだけで円板の表面抵抗が概ね10¹⁰ Ω/□変化し、円板の表面抵抗を10⁵~10¹¹ Ω/□の範囲で段階的に設定するのは困難であることがわかる。

[0042]

【表1】

表 1

		導電性調整材 (重量%)	炭素繊維群 (重量%)	合 計 (重量%)	表面抵抗 (ロノロ)
	1	3	9	12	2. 13×10 ⁵
実施	2	4	8	12	8. 01 × 10 ¹⁰
例	3	5	7	12	5. 28×10 ¹³
	4	6	6	12	1. 77×10 ¹⁵
比較	1	o	12	12	1. 05 × 10 ⁵
例	2	o	9	9	1. 01 × 10 ¹⁵

【0043】実施例5~7

高分子材料であるポリプロピレン樹脂(日本ポリケム株式会社の商品名"ノバテックBC3B")に対して上述の製造例で得られた導電性調整材と、平均繊維径が7μmでありかつ平均アスペクト比が857のポリアクリロニトリル系炭素短繊維(三菱レーヨン株式会社の商品名"パイロフィル")からなる、繊維群電気抵抗値が0.06Ωcmの炭素繊維群とを実施例1~4の場合と同様に2台の定量フィーダーを用いて混合し、導電性高分子材料組成物を得た。ここでは、ポリプロピレン樹脂中における炭素繊維群の含有量を7重量%に設定し、導50

40 電性調整材の含有量を3重量%、4重量%および5重量%の3種類に設定した。

【0044】得られた導電性高分子材料組成物をペレット状に成形し、このペレットを、樹脂温度230℃、射出圧力800kg/cm²および金型温度60℃の条件で住友重機械工業株式会社製のPROMAT射出成形機を用いて成形し、直径50mm、厚さ3mmの円板、すなわち高分子材料成形体を得た。得られた円板について実施例1~4の場合と同様にして表面抵抗を調べた結果を表2および図3に示す。

【0045】<u>比較例3</u>

11

実施例5~7において、導電性調整材を用いずに炭素繊 維群のみを用いて導電性高分子材料組成物を調製し、こ の導電性高分子材料組成物 (炭素繊維群含有量=7重量 %)を用いて実施例5~7の場合と同様にして高分子材 料成形体(円板)を得た。得られた円板について、実施* *例1~4の場合と同様にして表面抵抗を調べた結果を表 2および図3に示す。

[0046]

【表2】

		導電性開整材 (重量%)	炭素繊維群 (重量%)	合 計 (重量%)	表面抵抗 (ロノロ)
	5	3	7	10	1. 20 × 10 ⁵
実施例	6	4	7	11	1. 23×10 ⁴
	7	5	7	12	3. 50 × 10 ⁴
ŀ	比較例3	o	7	7	4. 68×10 ¹⁶

【0047】 実施例8~10

ポリプロピレン樹脂中における炭素繊維群の含有量を6 重量%に設定し、導電性調整材の含有量を4重量%、5 施例5~7の場合と同様に操作し、円板、すなわち高分 子材料成形体を得た。得られた円板について、実施例1 ~4の場合と同様にして表面抵抗を調べた結果を表3お よび図4に示す。

【0048】比較例4

※実施例8~10において、導電性調整材を用いずに炭素 繊維群のみを用いて導電性高分子材料組成物を調製し、 この導電性高分子材料組成物(炭素繊維群含有量=6重 重量%および6重量%の3種類に設定した点を除いて実 20 量%)を用いて実施例5~7の場合と同様にして高分子 材料成形体(円板)を得た。得られた円板について、実 施例1~4の場合と同様にして表面抵抗を調べた結果を 表3および図4に示す。

[0049]

【表3】

Ж

		導電性調整材 (重量%)	炭素繊維群 (重量%)	合計 (宣量%)	表面抵抗(Ωノロ)
	8	4	6	10	2. 45×10 ⁶
実施例	9	5	6	11	1. 19×10 ⁵
	10	6	6	12	1. 15×10 ⁵
ŀ	比較例4	0	6	6	6. 57 × 10 ¹⁵

【0050】実施例11

ポリプロピレン樹脂中における炭素繊維群の含有量を5 重量%に設定し、導電性調整材の含有量を6重量%に設 定した点を除いて実施例5~7の場合と同様に操作し、 円板、すなわち高分子材料成形体を得た。得られた円板 について、実施例1~4の場合と同様にして表面抵抗を 調べたところ、1.32×10゚Ω/□であった。

【0051】比較例5

実施例11において、導電性調整材を用いずに炭素繊維 群のみを用いて導電性高分子材料組成物を調製し、この 導電性高分子材料組成物(炭素繊維群含有量=5重量 %)を用いて実施例5~7の場合と同様にして高分子材 料成形体(円板)を得た。得られた円板について、実施 例1~4の場合と同様にして表面抵抗を調べたところ、 50 ことができる。

9. 87×10¹⁵ Ω/□であった。

[0052]

【発明の効果】本発明の導電性高分子材料組成物は、上 40 述のような特定の導電性調製材を含んでいるため、高分 子材料の導電性を所望の状態に安価に調整することがで きる。特に、この導電性高分子材料組成物は、炭素繊維 と上述の導電性調整材とを同時に含んでいる場合、炭素 繊維のみでは達成するのが困難であった電気抵抗値を達 成しやすくなる。

【0053】また、本発明の導電性調製材は、上述のよ うな工程を経て製造されたものであるため、安価に提供 でき、それ単独で、または炭素繊維と併用して、高分子 材料の導電性を所望の状態に安価にかつ容易に調整する

【図面の簡単な説明】

【図1】製造例で得られた導電性調整材を高分子材料に 混合した場合の残存繊維長とその重量分布との関係を示 すグラフ。

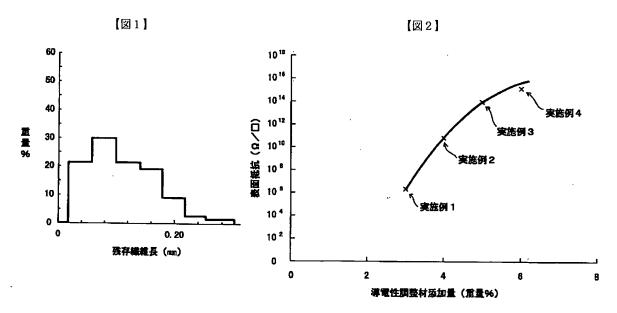
13

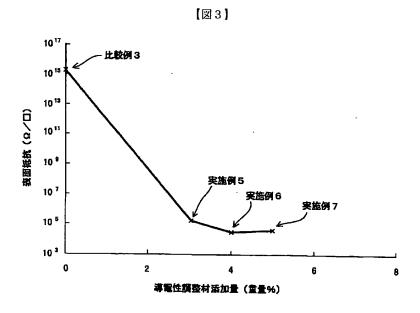
【図2】実施例1~4で得られた高分子材料成形体の表*

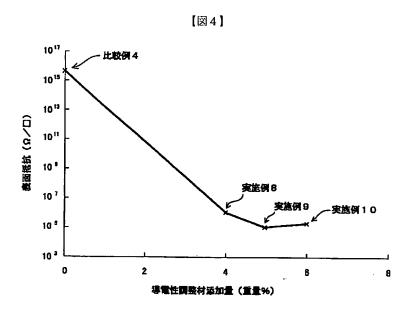
* 面抵抗をプロットしたグラフ。

【図3】実施例5~7および比較例3で得られた高分子 材料成形体の表面抵抗をプロットしたグラフ。

【図4】実施例8~10および比較例4で得られた高分子材料成形体の表面抵抗をプロットしたグラフ。







フロントページの続き

Fターム(参考) 4J002 AC011 AC031 AC061 AC071 AC081 AC091 BB031 BB121 BB151 BC031 BD141 BD151 BG041 BN151 CB001 CC031 CD001 CF061 CF071 CF211 CG001 CH041 CH071 CH091 CK021 CL001 CL011 CL031 CM041 CN011 CN021 CN031 CP031 DA016 FA046 FB016 FD116 GG01 GQ00